

证券代码：300136

证券简称：信维通信

公告编号：2025-011

深圳市信维通信股份有限公司 2024 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本 967,568,638 股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 15,100,031 股后的股份总数 952,468,607 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	信维通信	股票代码	300136
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	卢信	伍柯瑾	
办公地址	深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 A 栋北座 2 楼	深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 A 栋北座 2 楼	
传真	0755-86561715	0755-86561715	
电话	0755-33086079	0755-33086079	
电子信箱	ir@sz-sunway.com	ir@sz-sunway.com	

2、报告期主要业务或产品简介

坚守公司使命，为客户创造价值。公司始终坚守“致力于通过对基础材料、基础技术的研究，创造出值得信赖的创新产品与解决方案，为我们的客户创造价值”的使命，以材料为核心，通过对研发的持续投入，保持与国内、外知名大学和科研院所的合作与交流，加大对基础材料、基础技术的研究和积累，并以材料驱动业务发展，不断深化“材料->零部件->模组”的一站式研发创新能力，为客户提供更丰富的产品和解决方案。

践行公司核心价值观，实现可持续发展。公司坚持以本分、客户满意、结果导向、追求极致、勇于担当为核心价值

观，共识、共创、共担、共享，打造有战斗力的合伙人团队，通过多年与客户建立的良好合作关系以及持续的新业务拓展，实现可持续发展。在聚焦主业上，公司始终保持着较强的战略定力及战略落实、推进力，夯实消费电子核心领域业务的同时，积极挖掘新兴领域机会，布局具有前景的新兴产业项目，努力把产业做透做强，在市场波动以及持续动荡的外部环境中，为公司的长期健康发展积蓄力量，不断获得新的成长动能。

报告期内，公司主营业务包括天线及模组、无线充电及模组、EMI\EMC 器件、高精度连接器、汽车互联产品、被动元件等产品，可广泛应用于消费电子、物联网/智能家居、商业卫星通信、智能汽车等领域。



信维通信是一家全球研发、运营、销售的公司，业务与客户已遍及全球。迄今，公司在全球拥有 26 家子公司、11 个研发中心和 5 个主要生产基地，员工 13600 人，业务覆盖 8 个国家 18 个地区。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

元

	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
总资产	13,371,351,405.04	12,872,407,625.64	3.88%	12,213,915,334.95
归属于上市公司股东的净资产	7,309,002,684.99	7,029,589,379.32	3.97%	6,584,042,330.85
	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入	8,743,610,645.71	7,547,645,710.16	15.85%	8,589,916,593.29
归属于上市公司股东的净利润	661,605,544.10	521,403,065.93	26.89%	648,889,733.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	538,106,812.49	439,949,508.17	22.31%	503,432,824.35
经营活动产生的现金	1,075,900,583.38	1,818,388,216.72	-40.83%	1,193,336,883.79

流量净额				
基本每股收益（元/股）	0.6865	0.5389	27.39%	0.6706
稀释每股收益（元/股）	0.6865	0.5389	27.39%	0.6706
加权平均净资产收益率	9.15%	7.66%	1.49%	10.33%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,857,992,631.84	1,888,005,339.54	2,648,182,081.51	2,349,430,592.82
归属于上市公司股东的净利润	151,660,614.40	51,079,608.49	330,498,123.52	128,367,197.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	118,222,561.44	34,426,342.41	257,313,165.99	128,144,742.65
经营活动产生的现金流量净额	539,769,767.58	59,831,082.11	144,730,461.10	331,569,272.59

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	97,730	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	97,621	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
彭浩	境内自然人	19.48%	188,503,533.00	141,377,650.00	不适用	0.00			
全国社保基金一零三组合	其他	3.82%	37,000,000.00	0.00	不适用	0.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.37%	22,914,339.00	0.00	不适用	0.00			
中国工商银行股份有限公司	其他	2.30%	22,233,761.00	0.00	不适用	0.00			

一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金							
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.42%	13,764,400.00	0.00	不适用		0.00
中国建设银行股份有限公司—华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.96%	9,270,959.00	0.00	不适用		0.00
安耐德合伙人有限公司—客户资金	境外法人	0.80%	7,765,946.00	0.00	不适用		0.00
莱恩达集团有限公司	境内非国有法人	0.79%	7,673,182.00	0.00	不适用		0.00
周瑾	境内自然人	0.78%	7,570,694.00	0.00	不适用		0.00
易建东	境内自然人	0.67%	6,451,807.00	0.00	不适用		0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人彭浩先生与其他股东不存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
全国社保基金一零三组合	32,925,800	3.40%	74,200	0.01%	37,000,000	3.82%	0	0.00%
中国工商银行股份	11,353,511	1.17%	668,600	0.07%	22,233,761	1.56%	0	0.00%

有限公司 一易方达 创业板交 易型开 放式指 数证 券投资 基金								
中国农业 银行股 份有 限公 司一 中证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金	5,224,900	0.54%	1,567,800	0.16%	13,764,400	1.42%	0	0.00%
中国建设 银行股 份有 限公 司一 华安 创 业 板 50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金	7,111,772	0.74%	130,700	0.01%	9,270,959	0.96%	0	0.00%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

（一）经营情况概述

2024 年，在宏观经济发展稳中有进、消费电子市场复苏回升的背景下，公司保持原有业务优势的同时，积极推进四新业务（新行业、新客户、新技术、新产品），第二增长曲线业务在前期投入的基础上，得到了较明显的发展。报告期内，公司实现营业收入 874,361.06 万元，较上年同期增长 15.85%；实现归属于上市公司股东的净利润 66,160.55 万元，较上年同期增长 26.89%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 53,810.68 万元，较上年同期增长 22.31%，公司全年经营业绩实现了较快提升。

报告期内，公司天线、无线充电、精密结构件等业务持续保持市场优势，导入更多客户产品；高精密连接器、LCP 模组/毫米波天线、声学器件、UWB、汽车互联产品、缝隙波导天线、被动元件等新业务也逐步获得更多业务机会。除消费电子外，公司在商业卫星通信、智能汽车等应用领域取得了明显进展，逐步实现从消费电子到“消费电子+卫星通信+智能汽车”多业务发展阶段的跨越，为公司业务规模的扩大提供重要增长力量。

在公司的产品线中，天线一直是公司最核心也最具竞争力的产品类别。2024 年 6 月，公司凭借移动终端天线领域深耕积累的产品实力、行业地位、市场份额等多方面优势，成功获评由国家工业和信息化部发布的“制造业单项冠军企业”荣誉称号，体现了公司坚守主业，勇于攀登细分领域行业制高点，努力成为制造业细分领域发展领头雁、排头兵的坚持与决心。在高精密连接器方面，公司依托自身射频技术、磁性材料等技术优势，重点发展高速连接器、磁性连接器、BTB 连接器等高端细分领域，相关产品技术水平深受客户认可，除消费电子市场外，在商业卫星通信领域取得快速突破，业务规模持续扩大，已逐步成长为公司第二个主要下游应用领域；公司的高频高速连接器取得了在汽车和卫星通信等领域的突破。在 LCP 及毫米波天线模组方面，公司自主研发的 LCP 薄膜通过了美国 UL (Underwriter Laboratories Inc.) 认证，高频传输性能及可靠性等处于国内领先水平，已服务北美大客户，同时针对移动通信、智能网联汽车、卫星通信等相关领域的客户共同开展基于以 LCP 为代表的高分子先进材料的多种形态高性能毫米波天线解决方案的研究。在 UWB 业务方面，公司已有丰富的技术储备及专利布局，成功应用于智能汽车钥匙、智能门锁、智能医疗设备、智能安防、智能音响等物联网及智能家居产品，实现了公司在智能汽车、物联网/智能家居应用领域的业务拓展。随着客户产品智能化发展，公司的高精密结构件产品也取得新的业务进展，为配合终端设备更高密度电池的升级，公司已为客户提供可有效抵抗外部环境侵蚀和损伤且兼具轻薄性的不锈钢电池壳，这将帮助终端设备提高电池续航能力、带来更好的使用体验，随着客户需要的增加，未来公司这一业务的规模还将进一步扩大。在被动元件业务方面，公司持续完善深圳-日本-韩国-常州-益阳多地国际化研发体系及高端人才梯队建设，瞄准被动元件高端定位，成功研发的多款高端 MLCC 产品均已通过了大客户的测试，正逐步量产，并在材料、配方、先进工艺和关键设备等方面获得专利 60 余项，有力填补了国内高端 MLCC 技术空白；随着 AI 服务器等新兴领域的发展，高容、宽温等高端 MLCC 产品有明显的需求增长，公司将逐步形成 AI 服务器高端 MLCC 产品系列化布局。

智能汽车是公司另一重要下游应用领域，是公司产品应用的重要战略布局。公司积极拓展自有技术产品在该领域的应用突破，加大对客户及产品的拓展。截至报告期末，公司已取得更多国内外主机厂及 Tier1 的供应资质，并就车载天线、无线充电、USB Hub、线缆及连接器、Busbar、EMI\EMC 器件及精密结构件等产品达成了较明确的合作方向，预计在未来 2~3 年为公司的成长提供支撑。

随着公司业务规模的扩大以及对以技术驱动为导向战略目标的坚守，为吸收全球不同国家、地区的技术、人才优势，也为应对多变的国际贸易局势，公司的国际化布局最早在 2012 年开始，并于 2019 年在越南建立了公司的第一个海外生产基地；2024 年，公司又在墨西哥新增建立了第二个海外生产基地，并于同年完成对越南生产基地的扩建，进一步加大海外产能建设及业务规模，公司的国际化布局得到进一步完善，实现与全球客户的多元化合作。目前，公司已在全球拥有 26 家子公司、11 个研发中心和 5 个主要生产基地，业务覆盖 8 个国家 18 个地区。同时，公司也在深圳建设新总部基地，强化深圳技术研发+智能制造的核心作用。此外，为降低单一业务领域对公司生产经营的影响，公司近几年一直努力打造第二增长曲线业务。公司在商业卫星通信、智能汽车等新兴产业领域，已获得许多国内外客户认可，预计未来 2~3 年，公司新产品、新兴应用领域业务及国内业务的占比将进一步提高，原有单一业务领域占比相对降低，单一地区、业务对公司生产经营影响的风险可控。

在电子信息技术不断变革的快速发展浪潮下，公司坚守“致力于通过对基础材料、基础技术的研究，创造出值得信赖的创新产品与解决方案，为我们的客户创造价值”的使命，重视研发投入，积极把握技术创新趋势，挖掘客户需求，

将技术驱动融合在产品服务中，始终保持着源源不断的技术创新活力。截至 2024 年 12 月 31 日，公司共申请专利 4782 件；2024 年 1 月至 12 月新增申请专利 814 件，其中 5G 天线专利 267 件，LCP 专利 11 件，UWB 专利 23 件，WPC 专利 32 件，BTB 连接器专利 18 件，MLCC 专利 41 件、声学结构专利 271 件。报告期内，公司研发投入约 70,803.27 万元，占公司 2024 年营业收入的 8.10%，保持较高的研发强度，不断积累自身在基础材料、基础技术上的核心能力：

(1)基础材料：以村田、TDK、京瓷等优秀企业作为学习标杆，公司持续夯实高分子材料、磁性材料、陶瓷材料、散热材料等核心材料平台，加强在核心材料上的技术投入。在高分子材料领域，公司具有深厚的研发实力和丰富的应用经验，我们开发的 LCP 薄膜、LCP 柔性覆铜板、MPI 柔性覆铜板等产品目前已在国内外消费类终端客户的 RF 传输线、毫米波传输线、UWB 天线等应用领域实现量产，公司可为客户提供从薄膜材料到模组的一站式解决方案，在高频高速方案中有着广泛应用；LCP 薄膜作为公司自主开发的核心材料之一，它具有耐高温且热稳定性好、高频信号下传输损耗低、占用空间小等优点，在 5G 通信领域产品中已经大量使用，同时公司开展了 6G 前沿技术及先进材料的研发，应用前景会更加广泛。除了对已有产品的创新升级外，公司不局限于单一材料或技术的研发，积极探索同一材料在多个行业（如汽车、工业、航空等）的应用挖掘，以实现更广泛的商业价值和市场竞争力。在磁性材料上，公司有着深入而广泛的研究，已开发高频高功率低损耗磁性材料，是下一代无线充电技术的核心材料，在国内外客户移动终端的发射端均已应用并供货；另外，磁性材料还可帮助公司提升天线、射频模组等多类产品的竞争力。在陶瓷材料上，公司具备陶瓷材料和基础配方等研发能力，对 MLCC 等产品的生产具有重要意义，有助于降低生产成本，提高产品质量，增强公司产品的市场竞争力；公司研究的高频低损耗陶瓷材料在通信领域有很好的应用，特别是在高频通信和微波通信领域；通过对陶瓷材料应用的深入研究，可以进一步提升天线、阻容元件等产品性能，为客户提供更优质、高效的通信解决方案。在散热材料领域，公司已为北美客户提供核心芯片封装散热器件。

(2)基础技术：公司依托以中央研究院为核心的全球 11 个研发中心，开发前沿技术产品。公司在射频领域拥有显著的研发实力和技术优势，围绕 5G-A/6G 的技术目标，积极开发柔性可重构天线、卫星通信相控阵天线、毫米波雷达缝隙波导天线、高频封装天线、光学透明天线、UWB 天线模组等。随着 5G-A/6G 技术的不断发展，对终端天线模组的要求也越来越高，天线模组需要能够支持更高、更宽的频带范围，以确保在各种通信场景下都能实现稳定的信号传输；而终端设备的不断小型化和轻薄化，对天线模组的尺寸和集成度也形成了严格的限制，对天线材料及工艺也提出了更高的要求，公司对 5G-A/6G 天线模组做了大量的研究工作，公司还在无线充电领域储备了 NFC 无线充电、Qi2.0/Ki、高自由度充电技术等；在高速连接器领域正在开展满足高频高速需求的轻量化、低 Dk 介电材料的研发。

未来，公司将积极把握产业创新的机会，始终坚持对基础材料、基础技术的研究与投入，不断夯实企业核心竞争力、加强公司的运营能力，努力成为一家“产品领先+卓越运营”的技术驱动型企业。同时在内部管理上，公司还将继续强化预算管理、风险控制，不断探索更好的内部管理机制，完善内部管理措施，优化企业经营指标，履行 ESG 社会责任，坚持走绿色可持续发展道路，实现财务指标的稳步改善。